

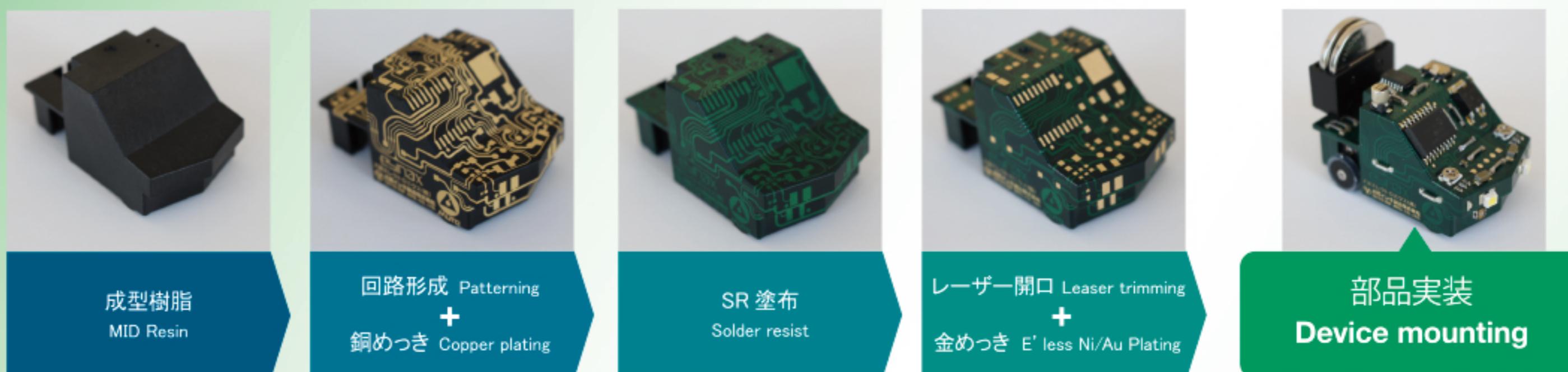


# 立体成型基板用ソルダーレジスト

## 3D-MID用ソルダーレジスト

### ● 3D-MID基板の作成方法

Process flow of 3D-MID



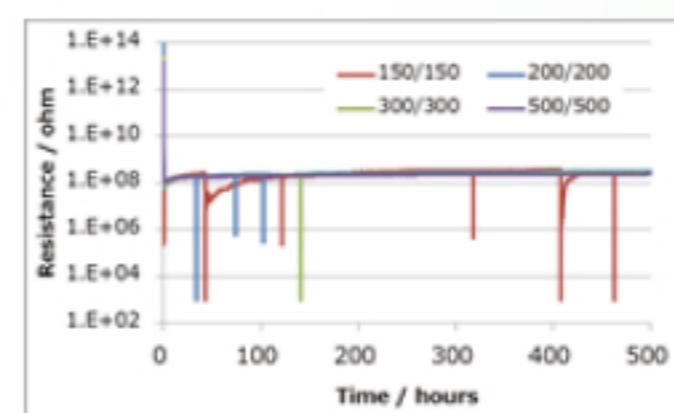
### ● ソルダーレジストの目的

Roles of Solder resist

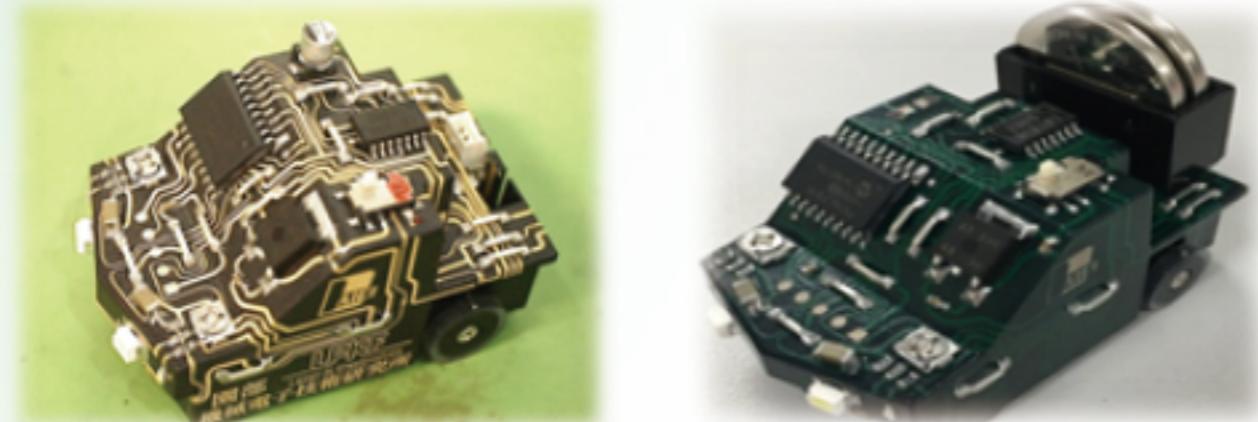
・実装時はんだ流れ防止  
Prevention of solder outflow



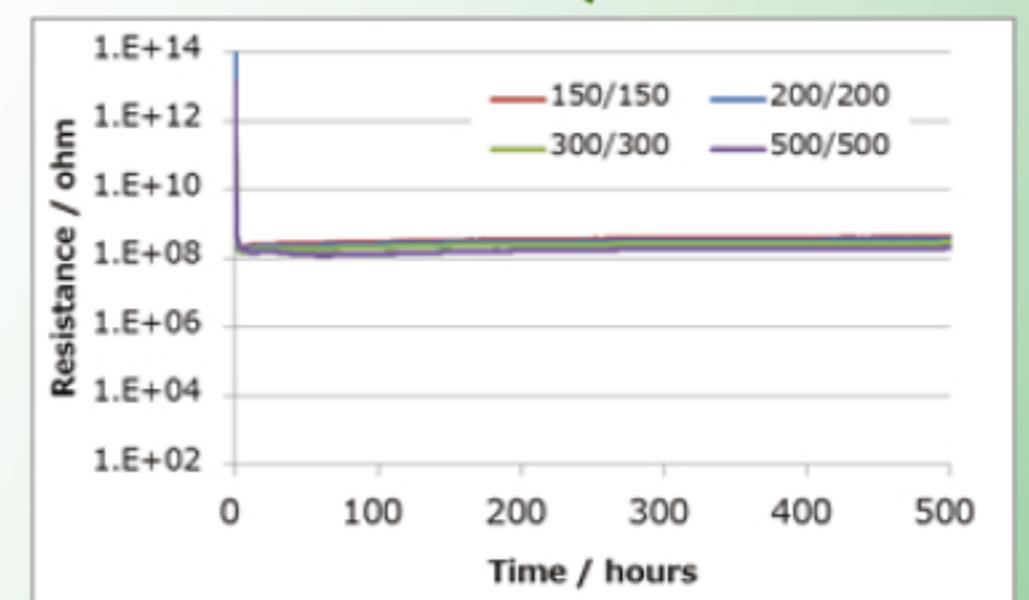
・高絶縁信頼性  
High insulation reliability



・金めっき削減によるコストダウン  
Cost reduction by reducing gold plating area



ソルダーレジスト  
があれば



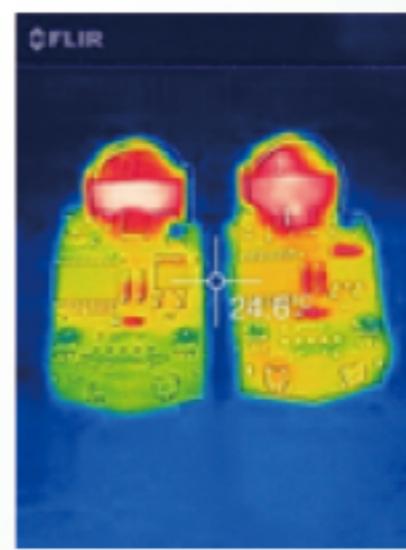
電気特性(85deg.C/85%RH/DC30V 基材:PA)  
L/S=150/150 , 200/200 , 300/300 , 500/500 um

### ● 放熱性向上対応等各種ソルダーレジストの使用が可能

Solder-resist depending on purpose is available



高放熱ソルダーレジスト塗布  
High insulation reliability



Actual temperature  
by thermo graph